

張致吉 簡歷

	姓名	張致吉
	學歷	國立交通大學 科技管理 -碩士畢業 私立輔仁大學 電子工程 -學士畢業
	現職	工業技術研究院產科國際所 經理
經歷	<ul style="list-style-type: none"> ● 工研院產業經濟與趨勢研究中心材料研究部 研究員，資深研究員，經理 ● 工研院材料與化工研究所積層陶瓷整合元件研究室 工程師 ● 工研院材料所 市場資訊室 副研究員，工程師 ● 工研院材料感測實驗室 助理研究員，副研究員 	
研究專長	<p>以半導體構裝(包含泛 3DIC 先進半導體構裝)與 PCB 之材料產業發展為主軸，研究範圍涵蓋：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 半導體製程材料 ■ 先進構裝材料 ■ 被動元件/電子陶瓷材料 ■ 高頻零組件/高頻通訊模組以及模組構裝用材料 ■ 稀土材料 ■ 熱管理材料 ■ 化合物半導體材料 <p>目前，主要專注在 5G/高頻/高功率用模組構裝材料與散熱材料，以及半導體產業循環經濟應用的分析。</p>	